

JIS

C 5012

プリント配線板試験方法

JIS C 5012-1993

(2004 確認)

平成5年5月1日 改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

主 務 大 臣：通商産業大臣 制定：昭和 49. 6. 1 改正：平成 5. 5. 1 確認：平成 11. 6. 20
官 報 公 示：平成 11. 6. 21
原案作成協力者：社団法人 日本プリント回路工業会
審 議 部 会：日本工業標準調査会 電子部会（部会長 多田 邦雄）

この規格についての意見又は質問は、経済産業省 産業技術環境局標準課 情報電気標準化推進室（〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1 丁目 3 - 1）へ連絡してください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第 15 条の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

プリント配線板試験方法

C 5012-1993

(1999 確認)

Test methods for printed wiring boards

1. 適用範囲 この規格は、主に電子機器に用いるプリント配線板(以下、プリント板という。)の試験方法について規定する。

備考1. ここでいうプリント板とは、その製造方法に関係なく、片面、両面及び多層プリント配線板とし、フレキシブルプリント配線板、フレックスリジッドプリント配線板及びメタルコアプリント配線板は除く。

2. この規格の引用規格を、付表1に示す。

3. この規格の対応国際規格を、次に示す。

IEC 326-2(1990) Printed boards. Part 2 : Test methods

IEC 326-4(1980) Printed boards. Part 4 : Specification for single and double sided printed boards with plain holes

IEC 326-5(1980) Printed boards. Part 5 : Specification for single and double sided printed boards with plated-through holes

IEC 326-6(1980) Printed boards. Part 6 : Specification for multilayer printed boards

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は、JIS C 0010及びJIS C 5603の規定による。

3. 試験の状態

3.1 標準状態 試験は、個別規格に規定がない限り、JIS C 0010の5.3.1(標準状態の範囲)による標準状態(温度15~35 °C, 相対湿度25~85 %, 気圧86~106 kPa)のもとで行う。ただし、この標準状態での判定に疑義を生じた場合、又は特に要求された場合は、3.2による。

なお、標準状態で試験を行うことが困難な場合は、判定に疑義を生じない限り標準状態以外の状態で行ってもよい。

3.2 判定状態 判定状態は、JIS C 0010の5.2(判定状態)による判定状態[記号Iの2級の条件(温度 20 ± 2 °C, 相対湿度60~70 %, 気圧86~106 kPa)]とする。

4. 試料

4.1 試料の作り方 試料の作り方は(1)又は(2)による。ただし、試料は、油類、汗その他によって表面を汚さないよう取扱いに注意する。

(1) 抜取りによる方法 実際に用いるプリント板から抜き取り、試料とする。個別規格で形状及び寸法の規定がある場合は、性能に影響を与えない方法で切断する。

なお、テストクーポンを設けてある場合には、これを試料としてもよい。

(2) テストパターンによる方法 4.2のテストパターンによる試料を、試験の対象とするプリント板と同一の材料及び製造方法で作る。

4.2 テストパターン プリント板の種類によって、付図1~2に示す寸法及びパターン形状を用いる。

5. 前処理 前処理は、個別規格の規定によって、(1)又は(2)による。